



2011年證券櫃檯買賣中心 法人說明會

報告人：張季明 總經理

April 21, 2011

公司概況(總部)

- 1999年10月成立
- 2005年1月上櫃(代號: 3264)
2011年3月31日市值: 新台幣117億元

- 公司地點: 新竹工業區

開源廠:

總樓層面積: 168,000 ft²

無塵室面積: 76,000 ft²

鼎興廠:

總樓層面積: 210,000 ft²

無塵室面積: 102,000 ft²

高昇廠:

總樓層面積: 138,500 ft²

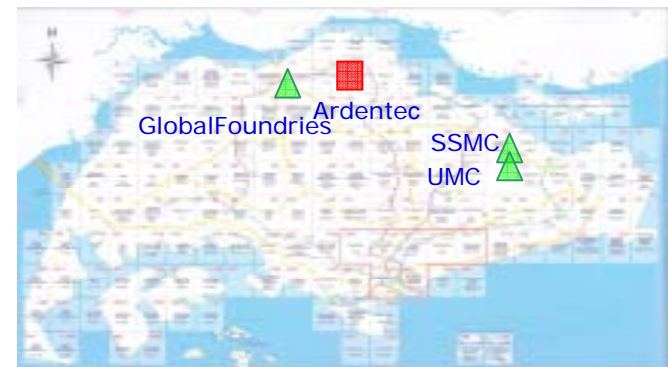
無塵室面積: 55,800 ft²

- 通過ISO9001, TS16949, ISO14001,
ISO27001, OHSAS18001及保稅工
廠認證。



新加坡子公司

- 2006年6月成立
 - 欣銓科技100%持有之子公司
- 實收資本額：星幣5,250萬元
- 公司地點：12 Woodlands Loop #02-00,
Singapore 738283
 - 總樓層面積： 81,000 ft²
 - 無塵室面積： 41,000 ft²
- 通過ISO9001, ISO14001, ISO27001 & OHSAS18001認證。



韓國子公司

- 2010年12月成立
 - 欣銓科技100%持有之子公司
- 實收資本額：134.4億韓元
- 公司地點：893-4 Eoyeon-ri,
Cheongbuk-myeon, Pyeongtaek City,
Gyeonggi Province, Republic of Korea
 - 總樓層面積：108,050 ft²
 - 無塵室面積：16,150 ft² (Jun. 2011)



系統封裝/裸晶測試技術的領先廠商

追求摩爾定律，系統封裝正是趨勢

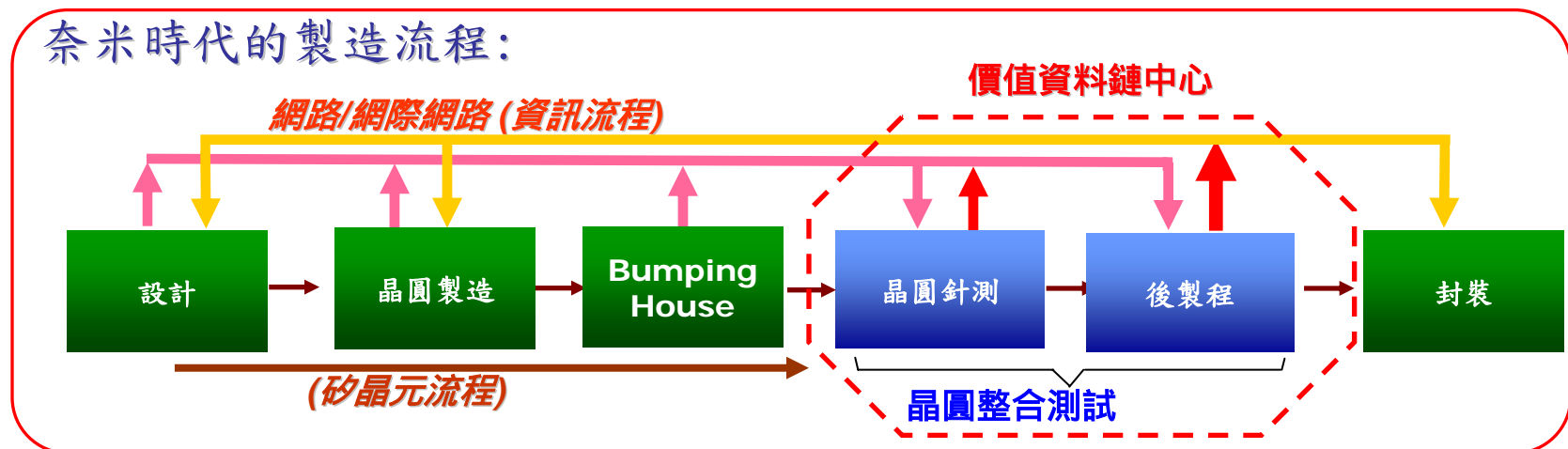
- 在趨向高度整合、SiP測試需求、異質多功能整合的無線元件市場，KGD (Known-Good-Die) 測試的需求與重要性日益增加。
- KGD 測試是目前主要的解決方案，因為沒有其他方式可以滿足在SiP 形式下所有的測試需要。

欣銓在KGD測試技術的貢獻

- 可靠性及品質篩選流程
 - 晶圓級預燒
 - 應用統計技術的品質篩選程序 (outlier process) 以及特定樣式異常的篩選
- 良率改善製程
 - 雷射修補
 - 類比信號微調
 - 註記編碼
- 高整合測試流程
 - 作業管制自動化IT系統
- 節省成本方案
 - 高並測數
- 高速測試
 - 可測試設計之結構測試
- 低功率及 & 行動性
 - 低溫及漏電流測試
- 晶圓製程線距微縮
 - 12吋晶圓針測
 - 鉚墊微距產品(Fine Pad Pitch)針測
 - 微距融絲(Fine Link Pitch)雷射修補
 - Low-k 銅製程鉚墊針測

在新興的價值鏈上扮演處理中心的角色

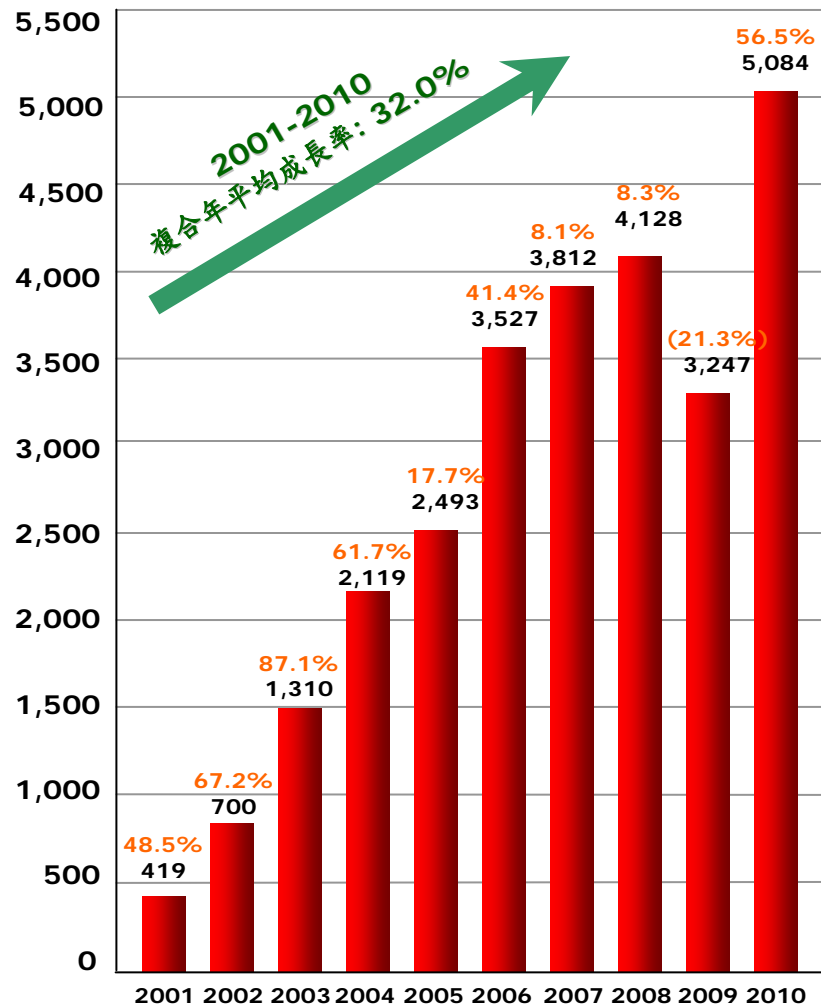
- 進入奈米時代，欣銓在後段流程中建立一個”後製程”（Post-Process）。
- 整合設計、製造、測試之所有數據，用以篩選 IC。
- 經由資訊高速公路，提供最廣泛的測試數據。
- 在有價值的數據鏈上扮演 “處理中心” 的角色。



營收成長

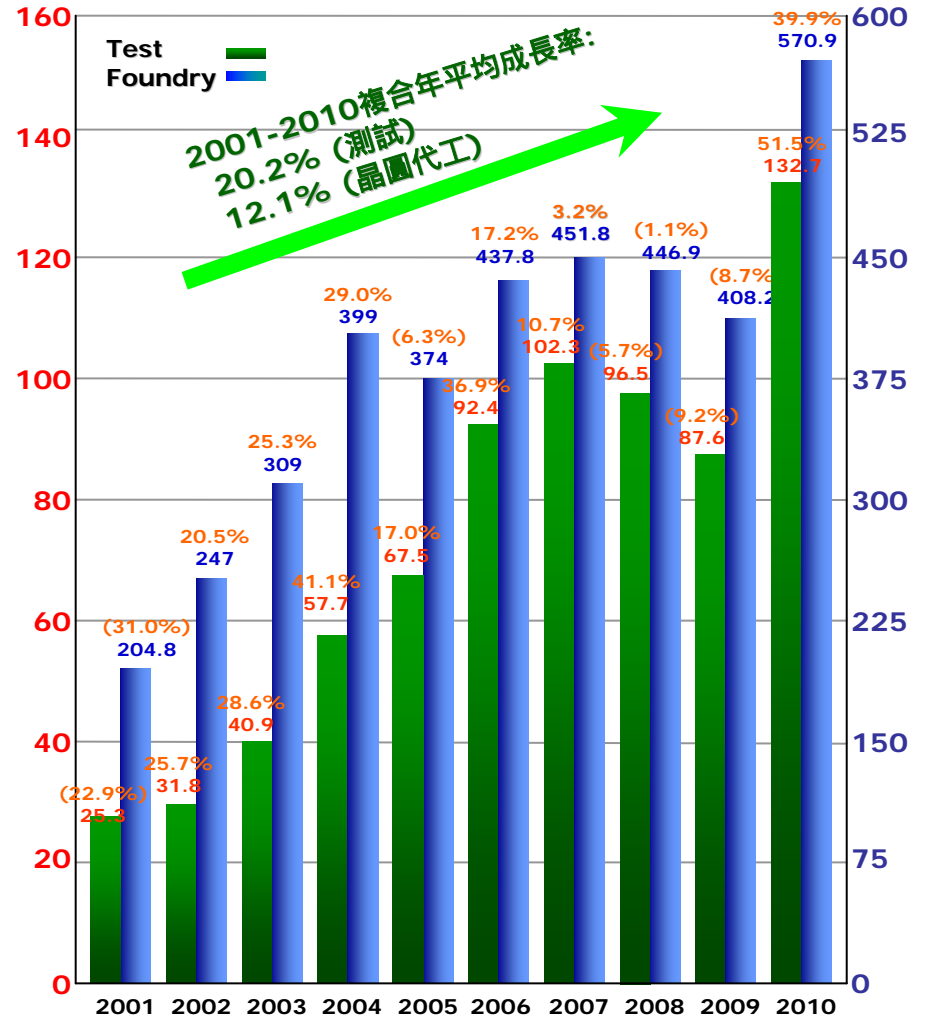
欣銓

(in NT\$M)



台灣半導體產業

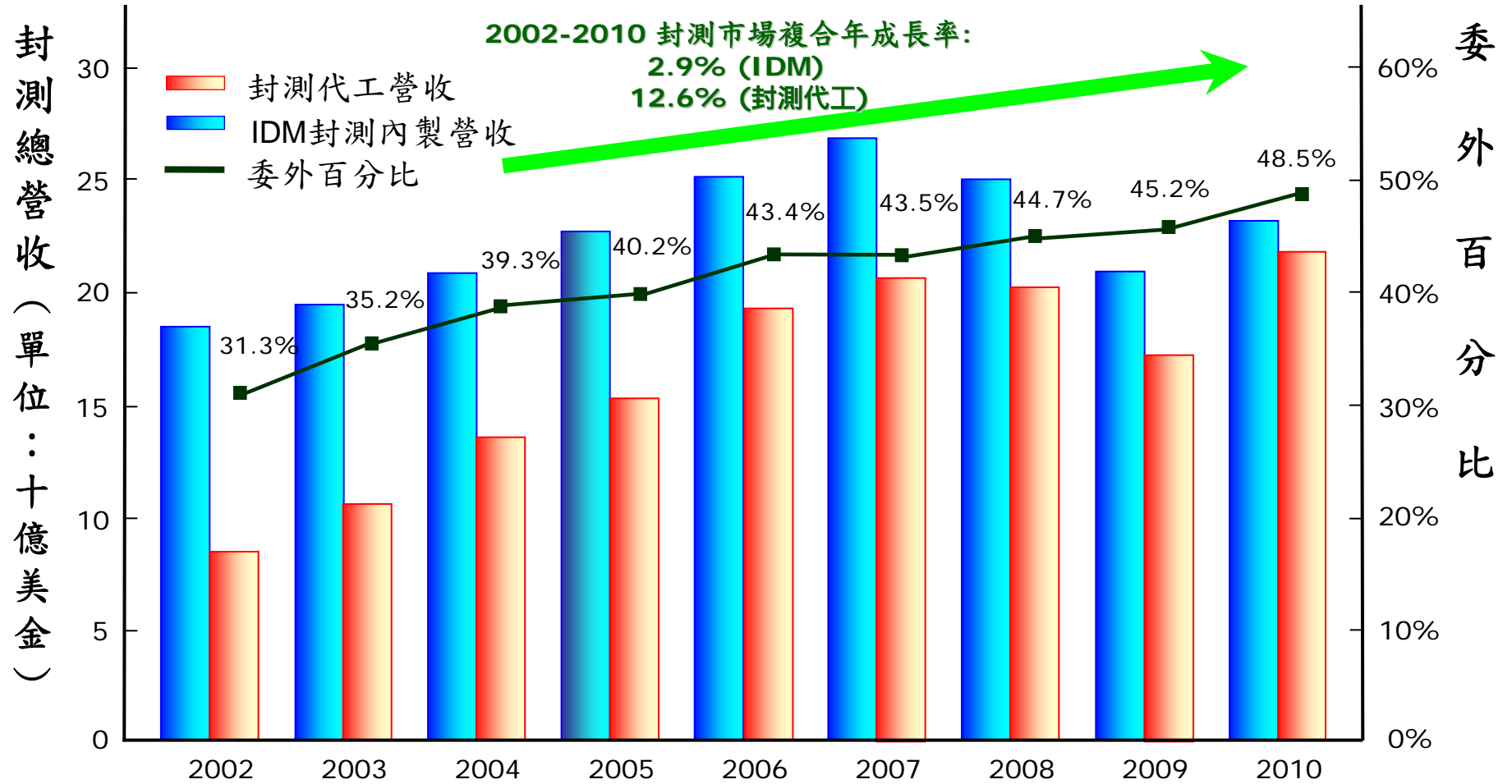
(in NT\$B)



Source: IEK/ITIS Feb. 2011

全球封測市場

委外趨勢持續上升!



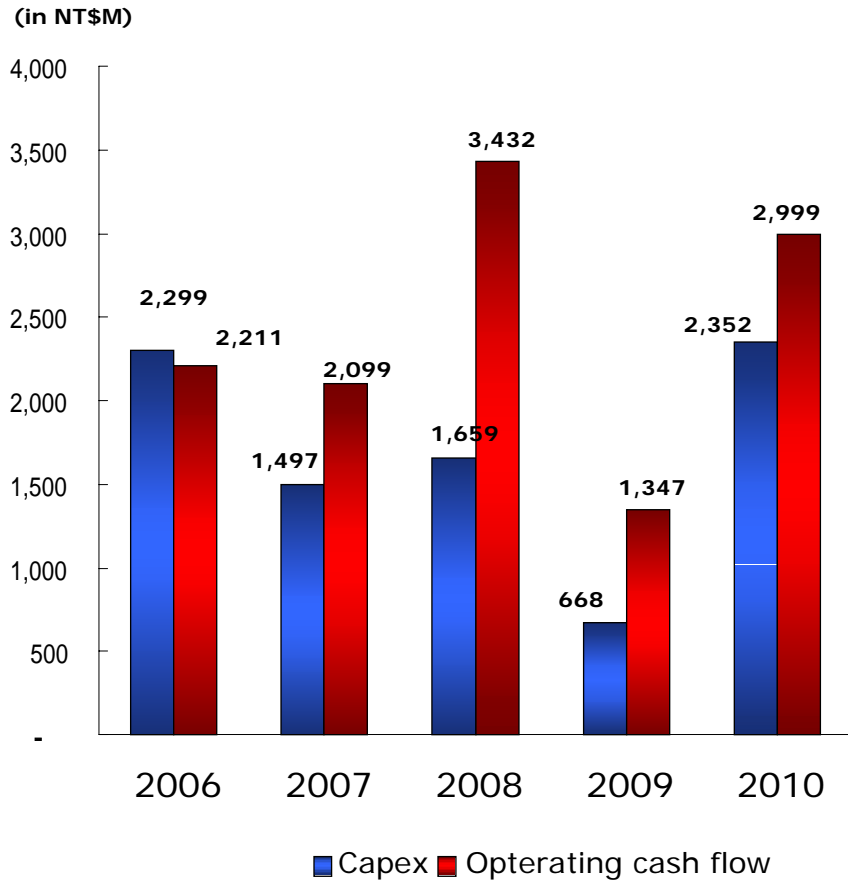
Source: Digitimes Research, March 2011

良好的財務比率(台灣)

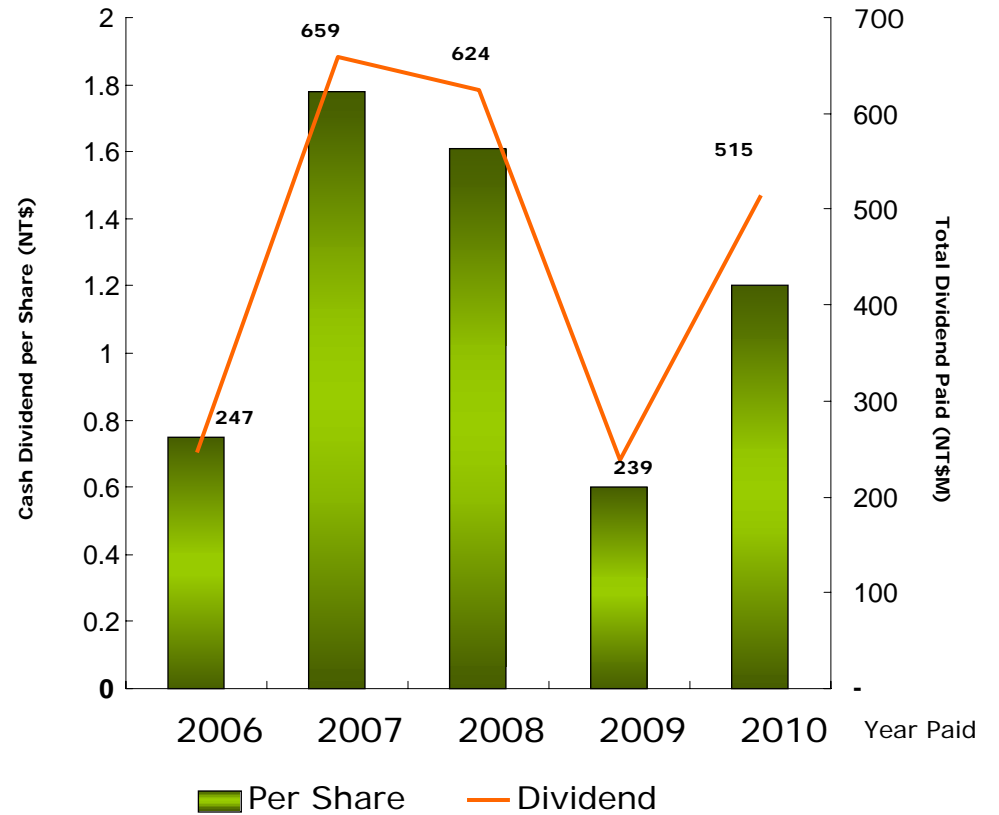
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
流動性比率									
流動比率	172%	173%	226%	177%	218%	201%	254%	291%	282%
速動比率	165%	168%	215%	167%	206%	195%	250%	285%	274%
資產管理比率									
固定資產週轉率	0.26	0.43	0.60	0.57	0.68	0.65	0.71	0.57	0.86
總資產週轉率	0.21	0.33	0.43	0.40	0.46	0.42	0.43	0.33	0.46
負債管理比率									
負債比率	51.0%	46.5%	31.3%	35.9%	29.6%	31.6%	27.0%	23.4%	27.8%
利息保障倍數	0.34	3.90	10.08	14.30	19.19	15.96	17.81	13.63	47.70
獲利性比率									
毛利率	10.7%	33.1%	45.3%	40.9%	42.2%	39.0%	39.9%	23.0%	39.0%
總資產報酬率	2.7%	11.4%	17.3%	13.7%	15.0%	12.3%	11.8%	4.81%	14.0%
股東權益報酬率	0.3%	17.6%	25.2%	19.3%	21.1%	16.6%	15.7%	5.96%	18.9%
每股盈餘(元)	0.03	1.78	3.00	2.62	3.05	2.62	2.53	0.94	3.21

現金流量 與 現金股息

Increased Capex to fuel growth



Cash Dividend will continue



2010 財務摘要

(In NT-K\$ excepted otherwise noted)

	2010	2009	YoY
淨營業收入	5,084,191	3,246,893	56.59%
營業毛利	38.58%	23.66%	14.92 pts
營業費用	30.37%	15.33%	15.04 pts
基本每股盈餘 (NT\$)	3.21	0.94	241%
自由現金流量 (FCF)(*)	646,936	678,823	-4.70%
現金股利	514,818	239,355	115.09%
現金及有價證券	3,102,119	2,224,909	39.43%
股東權益報酬率	18.87%	5.96%	12.91 pts

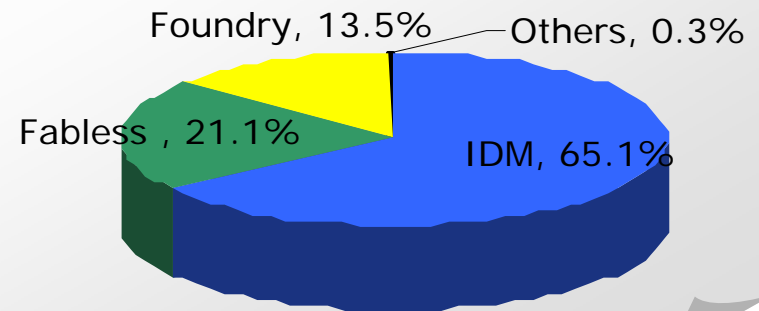
(*) Free Cash Flow = Cash from operating activities - Capital expenditures

- 創紀錄的營收和獲利!
- 經年充份利用產能!
- 持續以現金回饋股東!
- 強健的資產負債表能持續投資以追求未來成長!

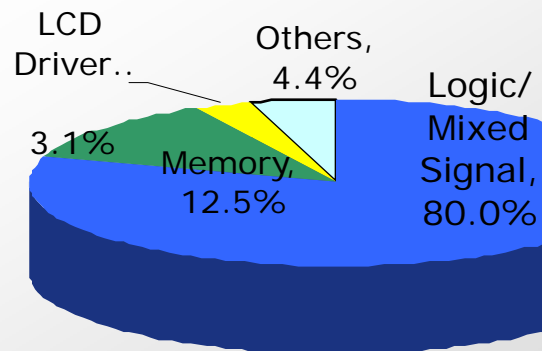
2010營收分類(合併)

*2010年合併總營收新台幣
50.8億, 比2009年營收成長
56.5%

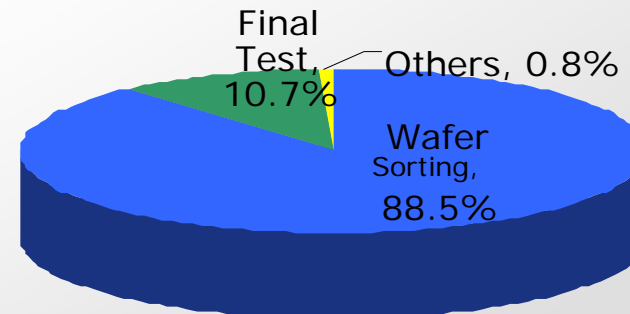
依客戶別分類:



依產品別分類:

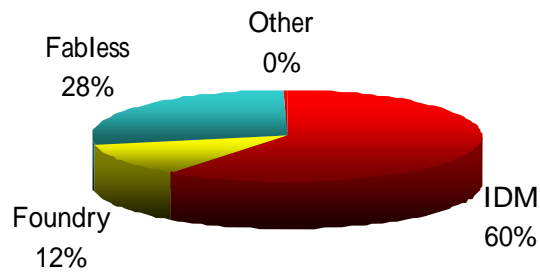


依測試別分類:

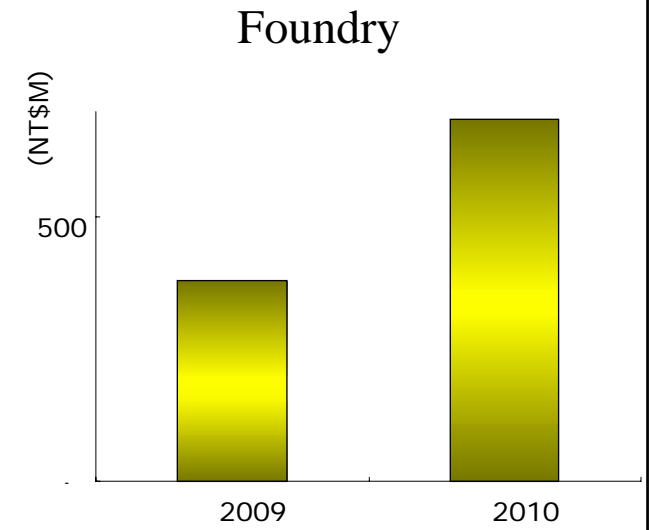
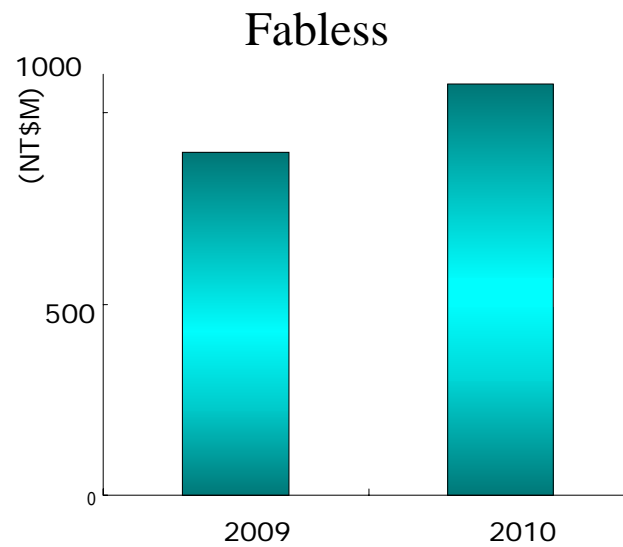
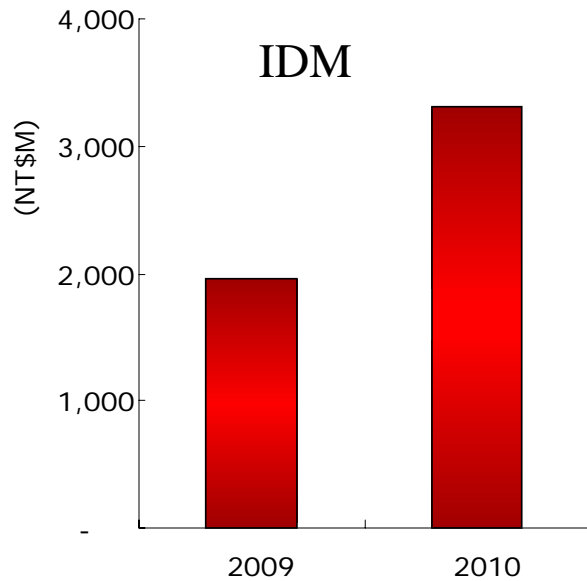
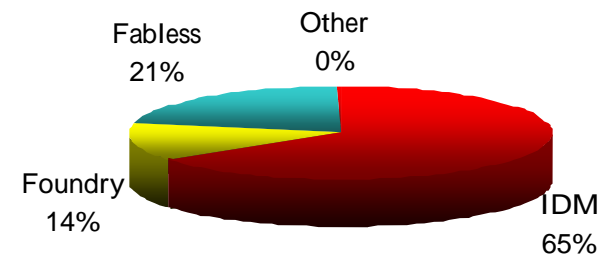


2010 vs 2009 收入別(合併)

2009



2010



大事紀

- 2010年9月榮獲美商捷橋科技(PLX)2009年度供應商獎
- 2010年9月榮獲財政部關稅總局通過AEO優質企業(Authorized Economic Operator, AEO) 認證
- 2010年10月獲得新竹科學園區管理局核准進入銅鑼園區
- 2010年11月完成台灣廠與新加坡廠的廠房設施擴充
- 2010年12月完成韓國子公司設立，地點位於京畿道平澤市
- 新加坡子公司自2007年開始營運以來，首度於2010年獲致全年盈餘成果
- 2011年3月榮獲中芯國際集成電路製造有限公司(SMIC)頒發2010年度優良服務供應商獎
- 2011年4月榮獲旺宏電子(MXIC)頒發2010年度最佳晶圓測試供應商獎

問與答

<http://www.ardentec.com>
Investors@ardentec.com